京二が半導体分野に攻勢

中国製工具は技術力も強みに

機械工具商社の京二（東京都千代田区、井口宗久社長）が、半導体分野に向けた提案を強化している。硬ぜい材の加工ニーズに焦点を当て、中国メーカー製の独自性のある工具の拡販に力を入れる。顧客への提案活動をより洗練させるべく、昨年には社内からの半導体関連の相談を受ける部署を設置した。

戦略を語る俞箴潔執行役員（＝写真右）と鍋田利幸室長

独自性のある製品が増える

京二は半導体分野の顧客開拓に戦略的に取り組む。提案する商材は主に、中国メーカー製の切削工具や砥石（といし）で、セラミックス素材をはじめ硬ぜい材の加工ニーズを狙う。中国では半導体産業の振興を国策として掲げており、関連技術への投資が活発化している。

俞箴潔（ユ・シンケツ）執行役員は「従来、中国メーカーは価格競争力が強みとのイメージが強かったが、近年は技術面も大きく進歩している」と指摘する。直径の非常に小さいダイヤモンド焼結体（PCD）マイクロドリルや、特徴的な構造の砥石など、独自性のある製品が増えているという。

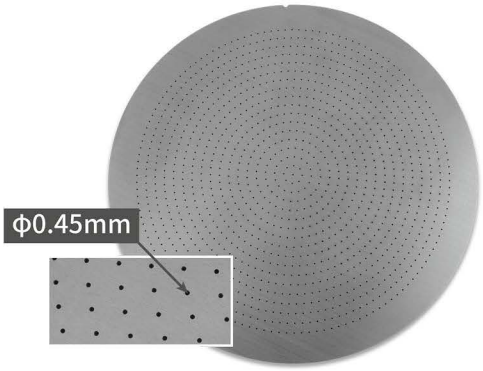
これまで同社は自動車分野を中心に超硬工具の販売量が多かったが、近年は電気自動車（EV）へのシフトなどから需要が伸び悩む。そこで成長分野であり、かつ国内や中国で販売実績のある半導体分野に狙いを定めた。新規開拓に加え、セラミックス加工用の研削盤を販売していた顧客に、砥石も提案するなどして課題解決を図る。

戦略の一環として、昨年10月には社内に「半導体相談室」を設置した。半導体関連の経験が少ない営業担当者などに対し、顧客への提案活動をサポートする。「初めての商談では、守秘義務の関係で顧客から開示される情報が限定的。わずかな情報に対して最適な提案をできるよう、営業担当と連携したい」と鍋田利幸室長は話す。

日本市場を重要視

多数の海外メーカー製品を取り扱う中、半導体分野には特に北京WORLDIA（ワールディア）の製品を訴求する。硬ぜい材の穴開けに使うPCDマイクロドリルは、直径0.1mmから標準品として作る。また、ウエハーの化学機械研磨（CMP）で使う研磨パッドが消耗した際、その表面を削って再生させるCMPコンディショナーなどもそろえる。

「北京WORLDIAは合併・買収（M&A）や生産能力の増強などで大きく成長している。日本市場を重要視しており、小ロットの注文や特注品の製造も積極的に受ける」と俞執行役員は説明する。他にもウエハーの切断用工具を製造するSAIY（サイヨー）など、半導体分野に強い複数の中国メーカーの製品を日



北京WORLDIAのドリルで微細な穴開け加工ができる（提供）

SAIYはウエハー切断用工具などをそろえる（提供）

本市場に展開する。

京二は2006年から本格的に中国製工具を取り扱い始めた。現地の工場を視察し、時には現場への指導もすることで製品の品質水準を高めてきた。「長年の実績があり、超硬工具も含めて商流を確立できている。供給面でのリスクが小さいこともわが社の強み」と俞執行役員は語る。

今年は半導体分野の開拓に向けた動きをさらに強める。10月に開催される第33回日本国際工作機械見本市（JIMTOF2026）の出展ブースでは、半導体に特化したコーナーを設置する予定という。「前回展で小さくコーナーを設けたところ、来場者の関心が高かった。需要の深耕に向けて積極的に取り組みたい」と鍋田室長は意気込む。　（水野敦志）